

技术参数

G5331

日期: 12/2016
网址: www.stick1mat.com



应用

特点 单组份热固化环氧胶水；具有各向异性导电性,适用于倒装芯片（例如：镍金和镀金材料）技术粘接使用，尤其适合智能标签和智能卡市场的应用粘接，在 150~210°C 下能快速固化；具有较高的耐温耐湿性（85 °C / 85 %）

粘接基材 PET, FR4、金属，玻璃，PCB 等

典型应用 RFID 智能卡芯片粘接应用

固化前特性

特征	数值	测试方法
外观	灰褐色	
粘度(cps)	28000	10rpm @25°C ASTM 0018
固化条件*	10s/180°C	
比重(g/cm3)	3.5	
储存<-20°C,月	6	

*固化温度指实际到达胶水的温度(最低固化温度 120°C, 更高的温度可加速固化)

固化后特性

特征	数值	测试方法
保压时间 (s)	6	
保压压力 (MPa)	0.3	
抗拉强度 (MPa)	50	DIN EN ISO 527
延伸率 (%)	1~2	
杨氏模量 (Mpa)	3300	DIN EN ISO 527
邵氏硬度(D)	85	ASTM D-2240
Tg(°C)	118	DSC, TA Q20, 40°C/Min
CTE(ppm/k)	α 1	61
	α 2	180
吸收率 (重量%)	<1	ASTM D 570-98
Na+ 含量 (ppm)	<10	
Cl-含量 (ppm)	<10	
F- 含量 (ppm)	<10	

存储&使用注意事项

本款胶水适用于半导体倒装芯片外露电触头粘接使用。可丝网印刷或涂覆施胶。使用胶水前建议被粘接表面必须保持干燥，无任何油脂及其他污染物

产品需要存储在-20°C以下，使用前产品需要回温，5ml 包装至少解冻 1 小时再打开包装。使用胶水时应避免眼睛和皮肤接触，对于接触部位应及时使用肥皂和清水清洗。

技术参数

G5331

日期: 12/2016

网址: www.stick1mat.com



包装

5ml, 10ml, 30ml 针筒包装

注:

本技术参数表所包含的参数是本产品最真实可靠的参数。对于其它机构测得的数据我们无法承担责任。客户最终决定本产品是否适用其工艺，对于生产过程中因使用不当产生的问题我们无法承担责任。建议客户正式使用前请做好各种测试工作。测试或使用中如有任何问题，请联系本公司的技术支持。